

# IR PRESENTATION

3Q 2019



creating value  
**together**

Investor Relations 2019

**WINPAC**  
Winner in Package & Test

본 자료는 기관 및 일반 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 윈팩 (이하 “회사”) 에 의해 작성되었으며, 본 자료를 복사, 재생, 배포 또는 게재하거나 다른 목적으로 사용하는 것은 엄격히 금지됨을 알려드립니다.

본 자료에 포함된 향후 실적과 전망 등의 ‘예측 정보’ 는 주식회사 윈팩의 현재 의견을 반영한 것으로 특정 위험이나 불확실성으로 야기될 수 있는 예기치 않는 사건으로 인하여 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

본 자료의 활용으로 인하여 발생하는 손실에 대하여 회사는 그 어떠한 책임도 부담하지 않으며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임소재의 입증자료로서 사용될 수 없음을 알려드립니다.

## I. 기업 개요

1. 기업 연혁
2. 기업 구조 & 주주 구성
3. CEO & 조직 구성
4. 사업 영역
5. 회사 전경

## II. 영업 현황

1. 연도별 경영실적
2. 분기별 경영실적
3. 2019년 3분기 경영실적
4. 연도별 투자 TREND
5. 수익성 및 재무구조

## III. 사업 현황 및 전략

1. 주요 경쟁력
2. 사업 전략
3. SKH PKG BIZ 강화
4. PKG PRODUCT ROADMAP
5. TEST INSTALLATION

## IV. APPENDIX

1. 수상 및 공헌활동
2. PKG PROCESS
3. FLIP CHIP PROCESS
4. TEST PROCESS

## 설립 및 전환기 ( 2002-2005 )

## FBGA PKG 특화

- 2002. 04 회사 설립 ( 아이팩 )
- 2004. 02 상호변경 ( 아이팩→윈팩 )
- 2004. 06 ISO 9001인증 획득
- 2005. 03 본사이전 ( 경기도 용인시 )
- 2005. 03 FBGA BOC Type 양산개시
- 2005. 05 기업부설연구소 설립

## 도약기 ( 2006-2009 )

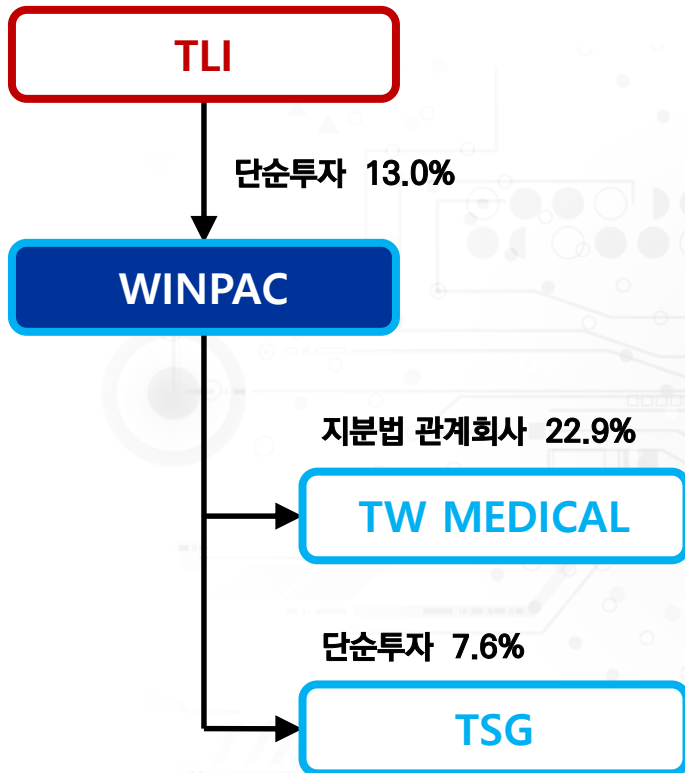
## 메모리 TEST 사업 추가

- 2006. 03 ISO 14001인증 획득
- 2006. 03 MCP/Flash Card 제품 양산개시
- 2006. 11 TS16949 인증획득
- 2007. 02 TEST 사업부 신설**
- 2007. 05 DRAM(DDR2) PKG,TEST 양산개시
- 2007. 07 DDR3 FBGA BOC Type 양산개시
- 2008. 06 MCP 외주 전문업체 선정(SKH)
- 2009. 07 DDR3 테스트 7Line 투자
- 2009. 09 경기도 유망중소기업 선정

## 성장기 ( 2010-현재 )

## DRAM 투자 &amp; 시스템 반도체 추가

- 2010. 02 TEST 공장동 증축
- 2010. 05 Advantest T5588 5Line 투자
- 2011. 04 대주주변경 ( TLi )**
- 2011. 09 SKH TEST 1,500일 무사고
- 2012. 03 경기도 성실납세자 선정
- 2012. 05 자본금 증자 (자본금 58억)
- 2012. 09 시스템반도체 TEST 장비투자
- 2012. 12 시스템반도체 양산시작**
- 2012. 12 5천 만불 수출의 탑 수상
- 2013. 02 PKG 1000일, TEST 2000일 SKH 무사고 달성
- 2013. 03 코스닥 상장업체 등록**
- 2014. 09 응용복합제품 양산시작
- 2016. 02 이한규 대표이사 취임
- 2018. 03 SK Hynix TDBI Test 양산개시
- 2018. 11 신 공장 준공 (Clean Room 1,000py)**
- 2019. 03 SK Hynix Flip Chip 양산개시



### 주요주주 현황

주주명		주식수(주)	지분율
최대주주 및 특수관계인	(주)티엘아이	4,851,180	13.02%
	(주)센소니아	1,195,219	3.21%
	이한규 (CEO)	769,230	2.06%
	김달수	500,000	1.34%
	윤공수	20,806	0.06%
	홍순원	19,864	0.05%
소계		7,356,299	19.75%
신한금융투자		1,195,218	3.21%
기타		28,699,368	77.04%
소계		29,894,586	80.25%
발행주식 총수		37,250,885	100.00%

### 전환사채 현황

구분	권면총액 (원)	잔여액 (원)	전환가액 (원)	전환가능주식수 (주)	전환기간	
					부터	까지
5CB	45억	15억	1,255	1,195,219	2018-08-17	2021-07-17
6CB	60억	60억	1,344	4,464,285	2020-04-05	2022-03-05
계	105억	75억		5,659,504		

## CEO



## 이한규 대표이사

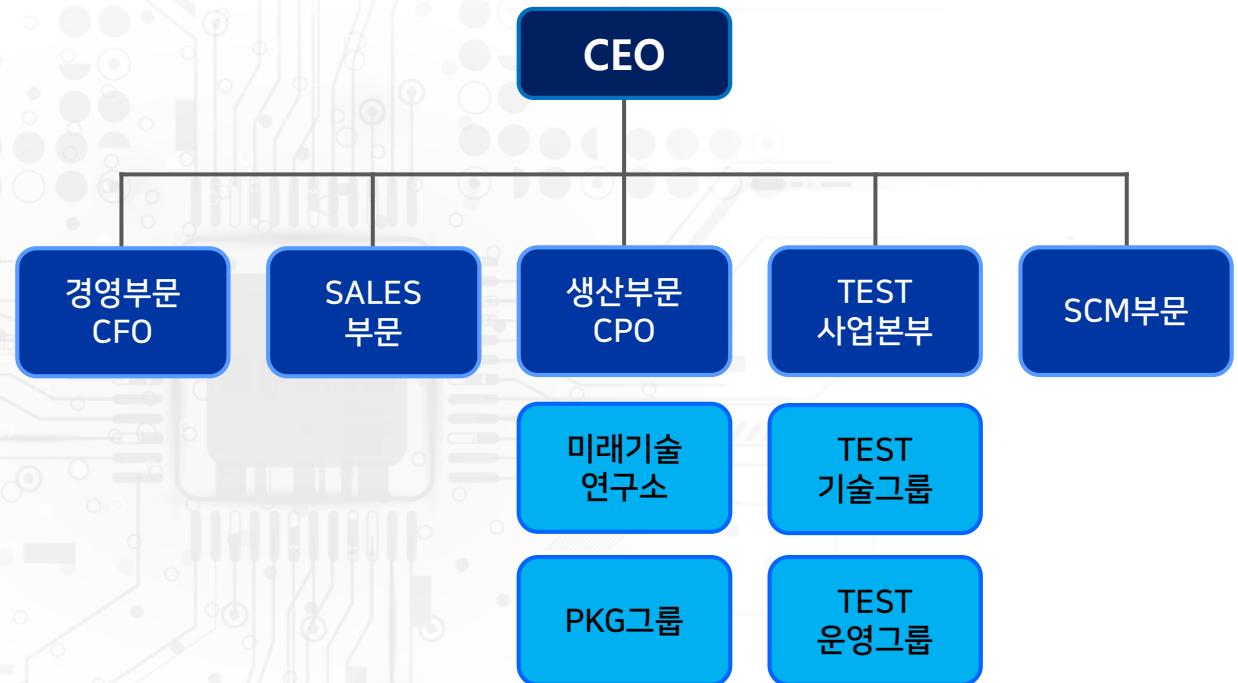
한국항공대학교 전자공학과

1989 ~ 2006 SK하이닉스 제품기술, TEST기술

2006 ~ 2014 (주)티엘아이 생산, 구매 총괄

2011 ~ 현재 (주)윈팩 대표이사

## 조직 구성



## Semiconductor Package & Test Solution Provider

### TURN-KEY SYSTEM



#### PROBER TEST

- SOC Wafer TEST
- Equip. : V93K

MAJOR CUSTOMER  
TLI, SENSONIA, JSC, ETC.

#### PACKAGE ASSEMBLY

- **Memory & Non Memory Package Assembly**
- Product Portfolio  
BOC, COB, MCP, POP, E-MCP, CI-MCP, EMMC, TSOP, QFN, UFD, LGA, LQFP, SENSOR, ETC.
- Near Future Plan  
E-POP, FC-BOC, FC-FBGA

MAJOR CUSTOMER  
SK HYNIX, JSC, FIDELIX, TLI, ESSENCORE, ETC.

#### TDBI TEST

- Memory Burn-In TEST
- Equip. :  
TDBI (1500HS)  
SKH Consign Equip.

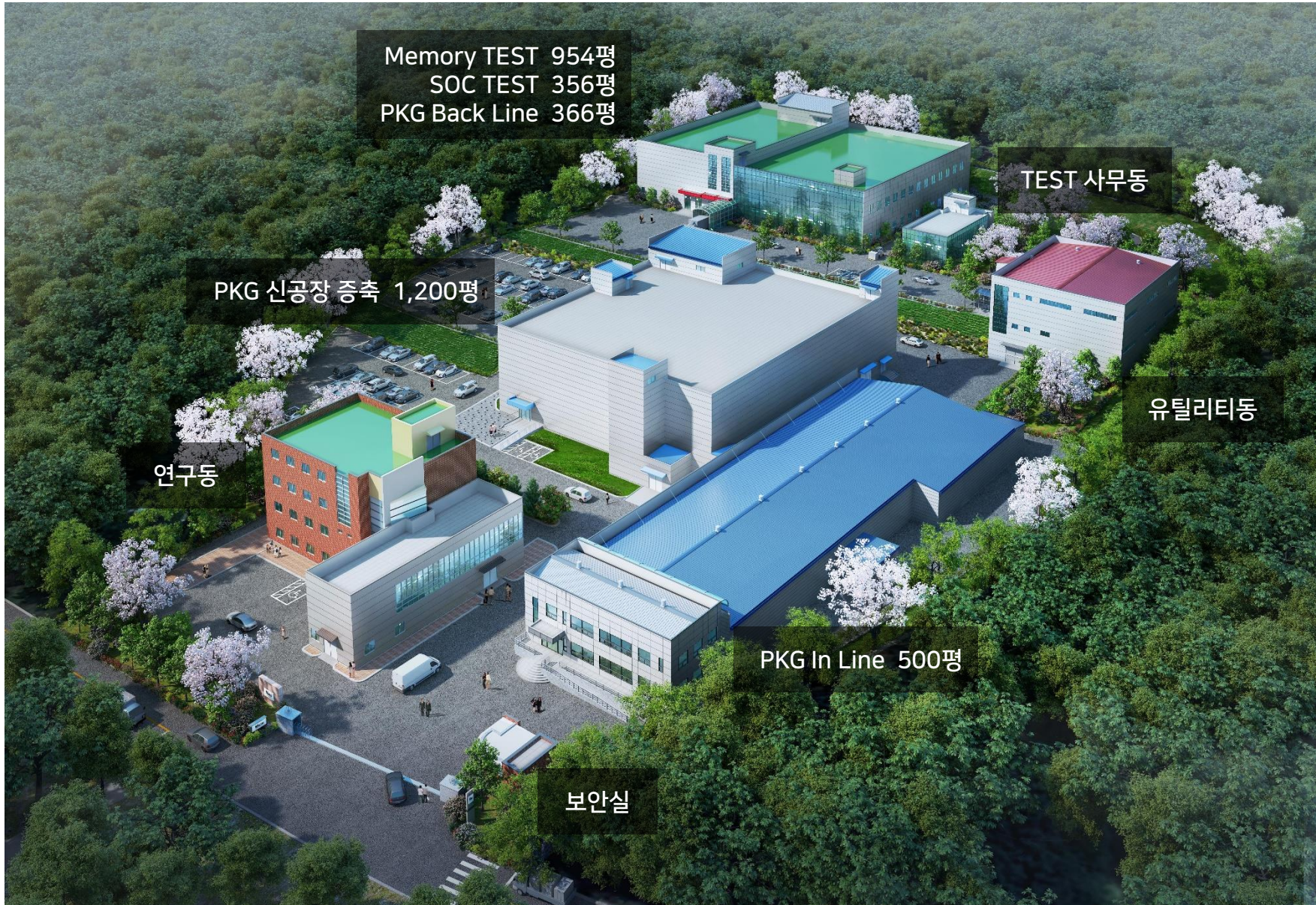
MAJOR CUSTOMER  
SK HYNIX

#### FINAL TEST

- **Memory & Non Memory Final TEST**
- Memory Tester  
T5588, T5588S, T5503, T5377S, T5581, T5585(SKH), UNI560(SKH)
- Non-Memory Tester  
V93K

MAJOR CUSTOMER  
SK HYNIX, ESSENCORE, TLI, TIGO, TEAMGROUP, ETC.

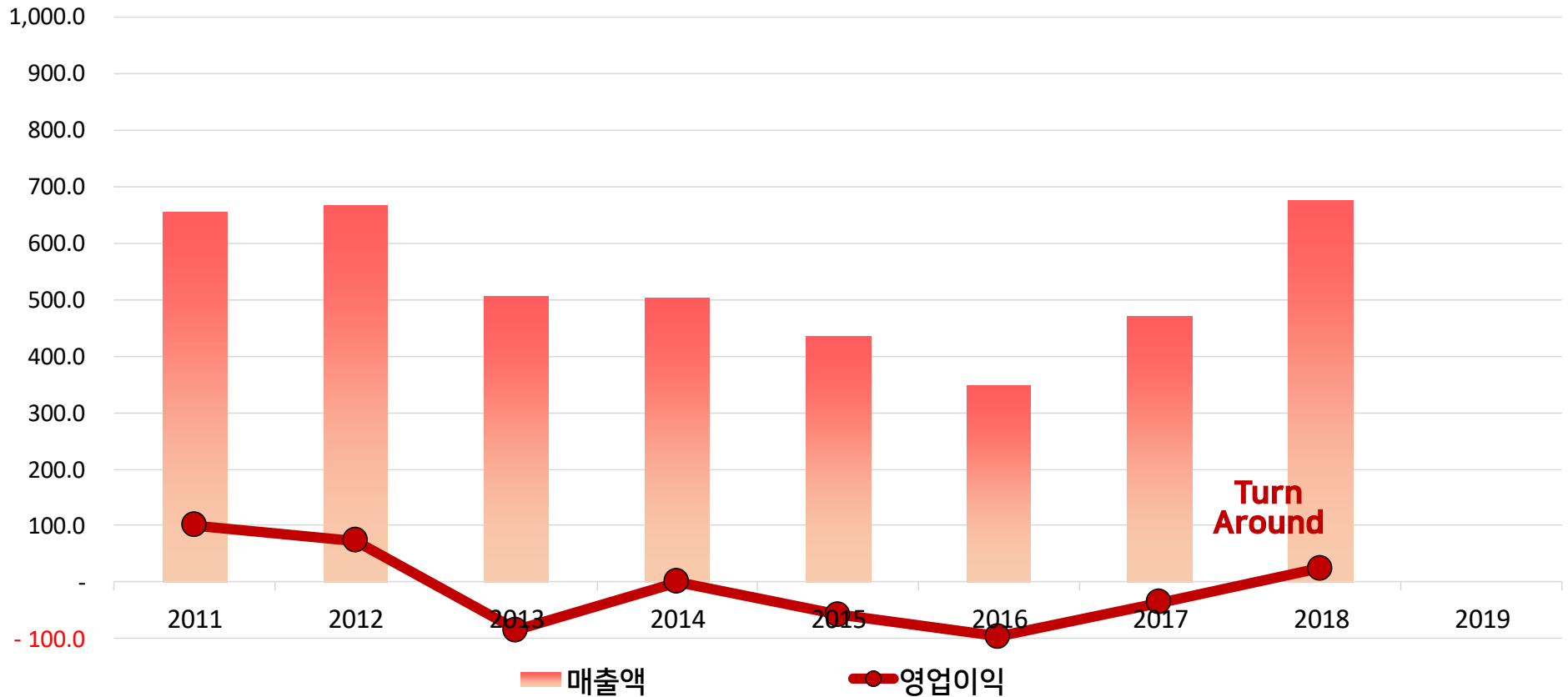






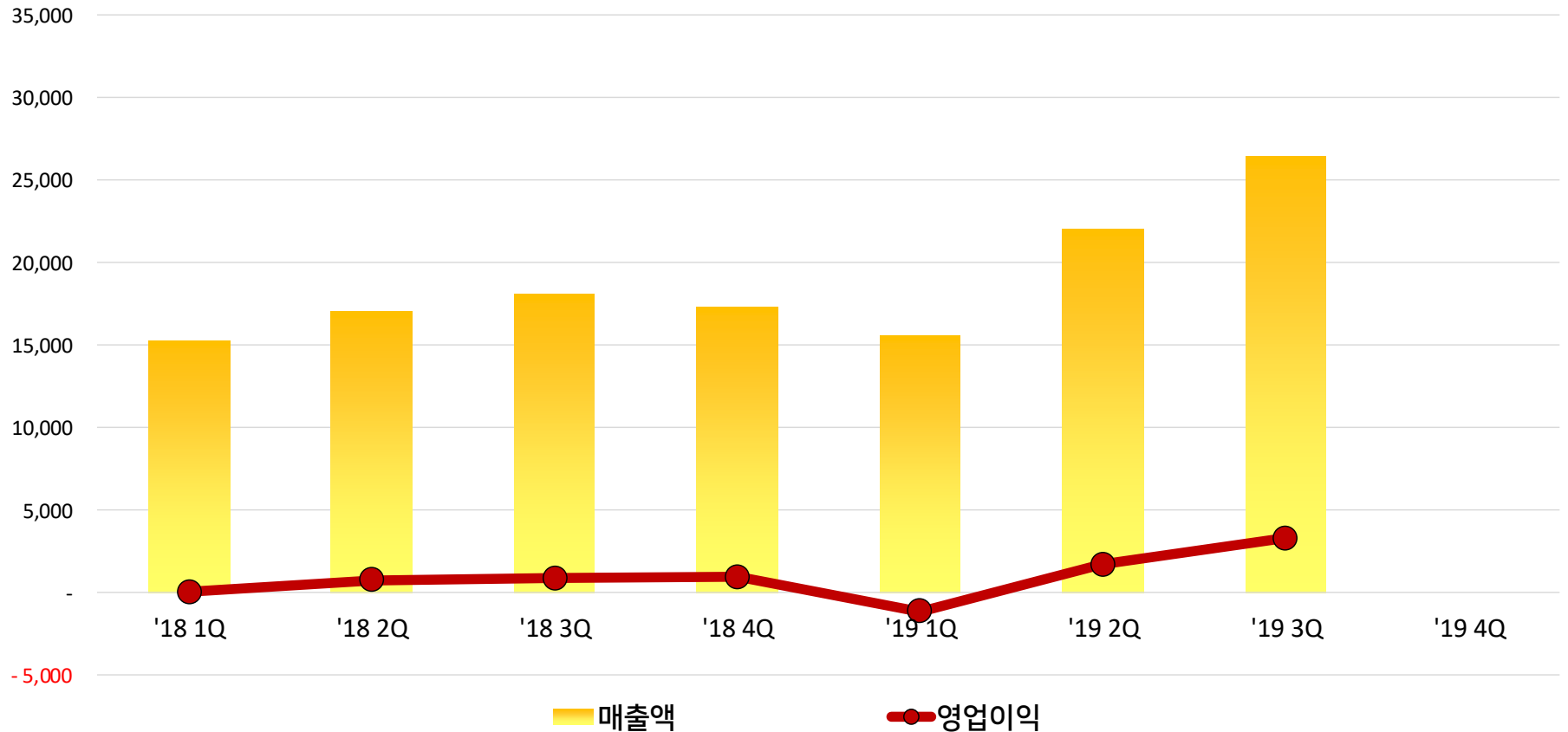
(단위 : 억원)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
매출액	654.9	666.8	504.6	503.0	433.3	347.4	471.5	675.1	
매출원가	521.6	557.3	543.8	471.1	459.0	412.9	480.5	616.0	
영업이익	100.8	72.8	-84.4	0.9	-57.1	-96.0	-36.1	24.3	
영업이익률	15.4%	10.9%	-16.7%	0.2%	-13.2%	-27.6%	-7.7%	3.6%	



(단위 : 백만원)

구분	'18 1Q	'18 2Q	'18 3Q	'18 4Q	'19 1Q	'19 2Q	'19 3Q	'19 4Q
매출액	15,245	16,995	18,052	17,317	15,572	22,035	26,386	
매출원가	14,491	15,442	16,254	15,511	15,833	19,039	22,089	
영업이익	30	732	848	924	- 1,152	1,686	3,287	
영업이익률	0.20%	4.31%	4.70%	5.34%	-7.40%	7.65%	12.46%	



**3개월**

(단위 : 백만원)

구 분	2019 3Q	2018 3Q	YoY
매출액	26,386	18,052	46.17%
매출원가	22,089	16,254	
영업이익	3,287	848	287.62%
영업이익률	12.5%	4.7%	
당기순이익	2,463	660	273.18%
당기순이익률	9.3%	3.7%	

**누적**

(단위 : 백만원)

구 분	2019 3Q	2018 3Q	YoY
매출액	63,993	50,292	27.24%
매출원가	56,961	46,186	
영업이익	3,822	1,610	137.39%
영업이익률	6.0%	3.2%	
당기순이익	2,268	708	220.34%
당기순이익률	3.5%	1.4%	

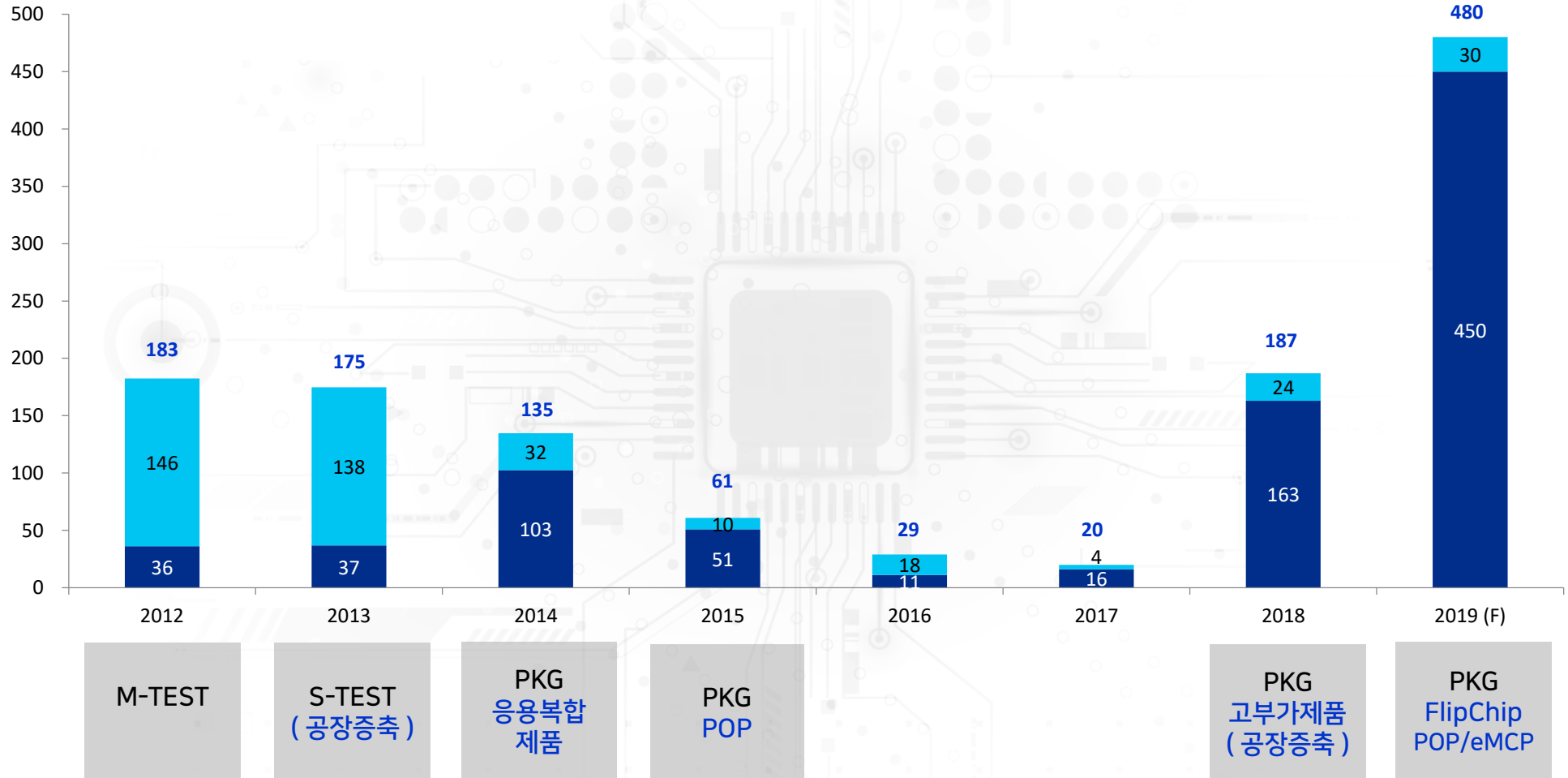
**매출 증가 요인**

- BoC 제품군의 Flip Chip 제품 전환
- 복합 응용 제품 ( POP/EMCP ) 매출 확대
- ECS 고객사 매출 확대

**이익 증가 요인**

- 매출규모 증대에 따른 고정비 분산
- PKG 공장 증축에 따른 생산성 향상
- PKG 장비 투자에 따른 양산 대응
- 환율 상승

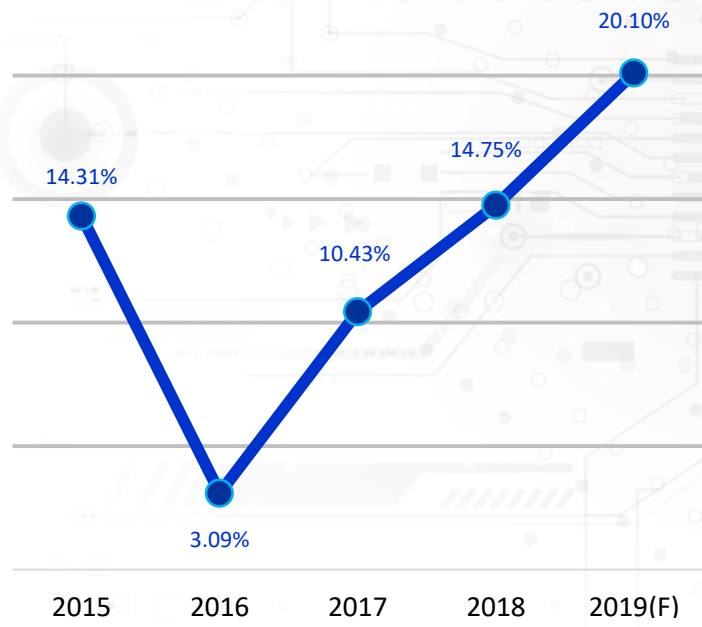
■ PKG ■ TEST (단위 : 억원)





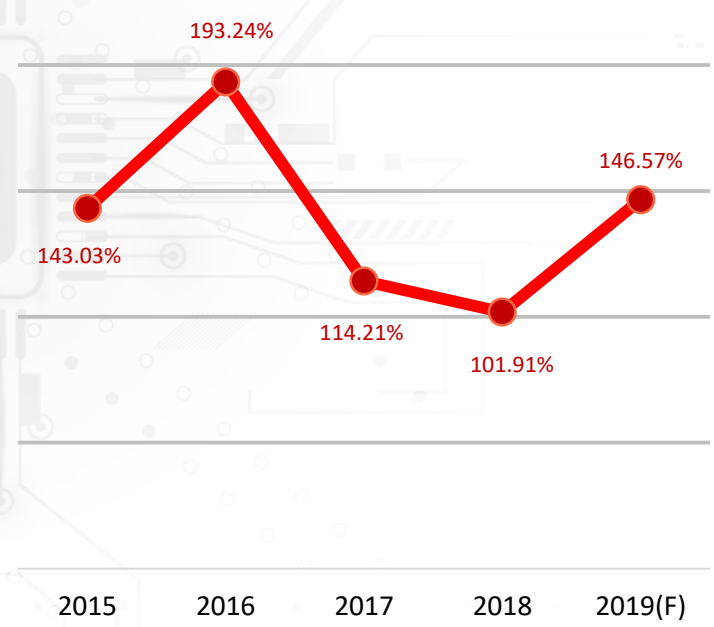
수익성

EBITDA / SALES



재무구조

부채비율



## “ 일괄 처리 프로세스로 수익구조 안정성 확보 및 생산 효율성 제고 ”

### 당사 일괄처리 공정의 장점

#### • 수익구조의 안정성 확보

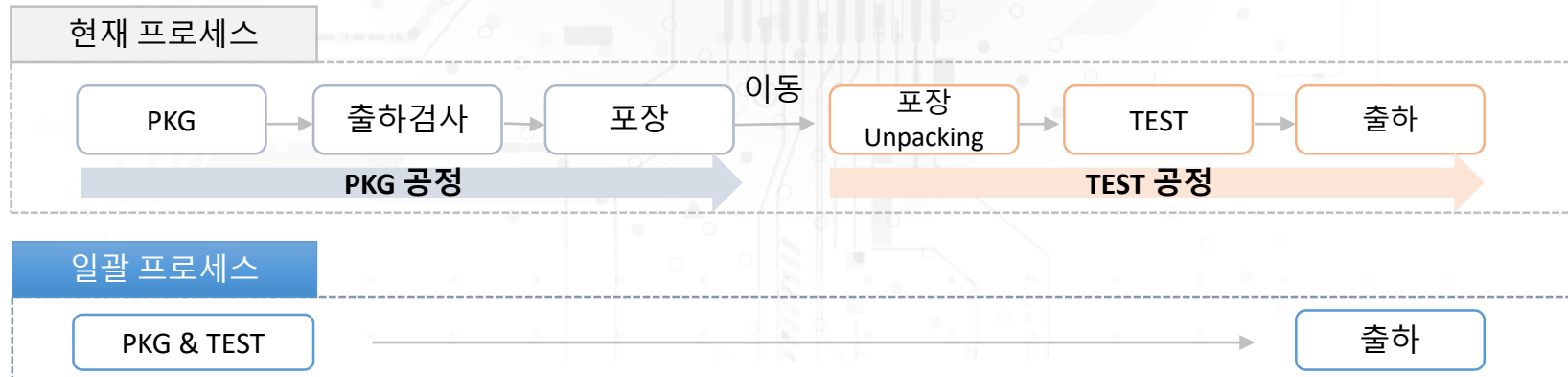
- 변동성이 높지만 규모가 큰 패키징 사업과 손익분기 매출 이상 달성시 레버리지 효과가 큰 테스트 사업 영위
- 양 사업의 동시 영위를 통해 규모의 확대 및 수익구조의 안정성 확보

#### • 사업부간 시너지 창출

- 패키징 기술 확보로 테스트 불량 발생시 원인 분석 및 개선 방안 도출로 수율 향상

#### • 생산 효율성 제공

- Turn-key 발주로 물류비용 및 제조 단가 절감
- 일괄 처리를 통한 생산관리 및 효율성 증대
- 글로벌 후공정 업체들은 패키징과 테스트를 함께 진행 중



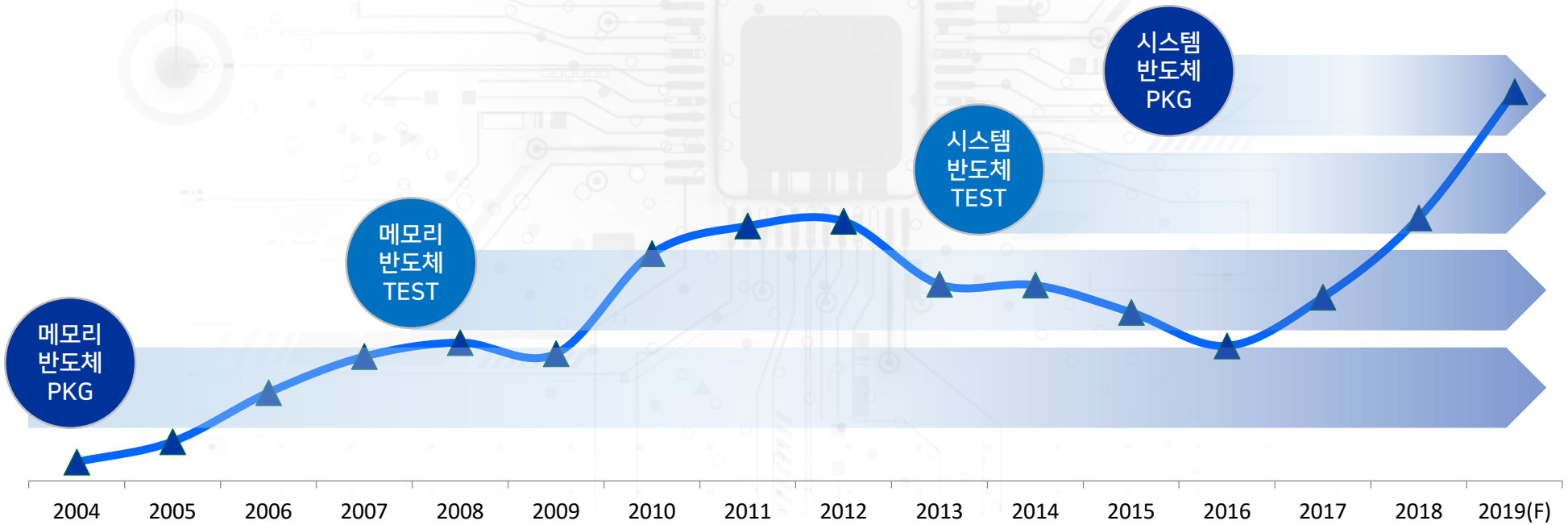
“ 고객 포트폴리오 다변화 및 고부가가치 제품 집중을 통한  
안정적 매출 및 수익구조 개선 ”

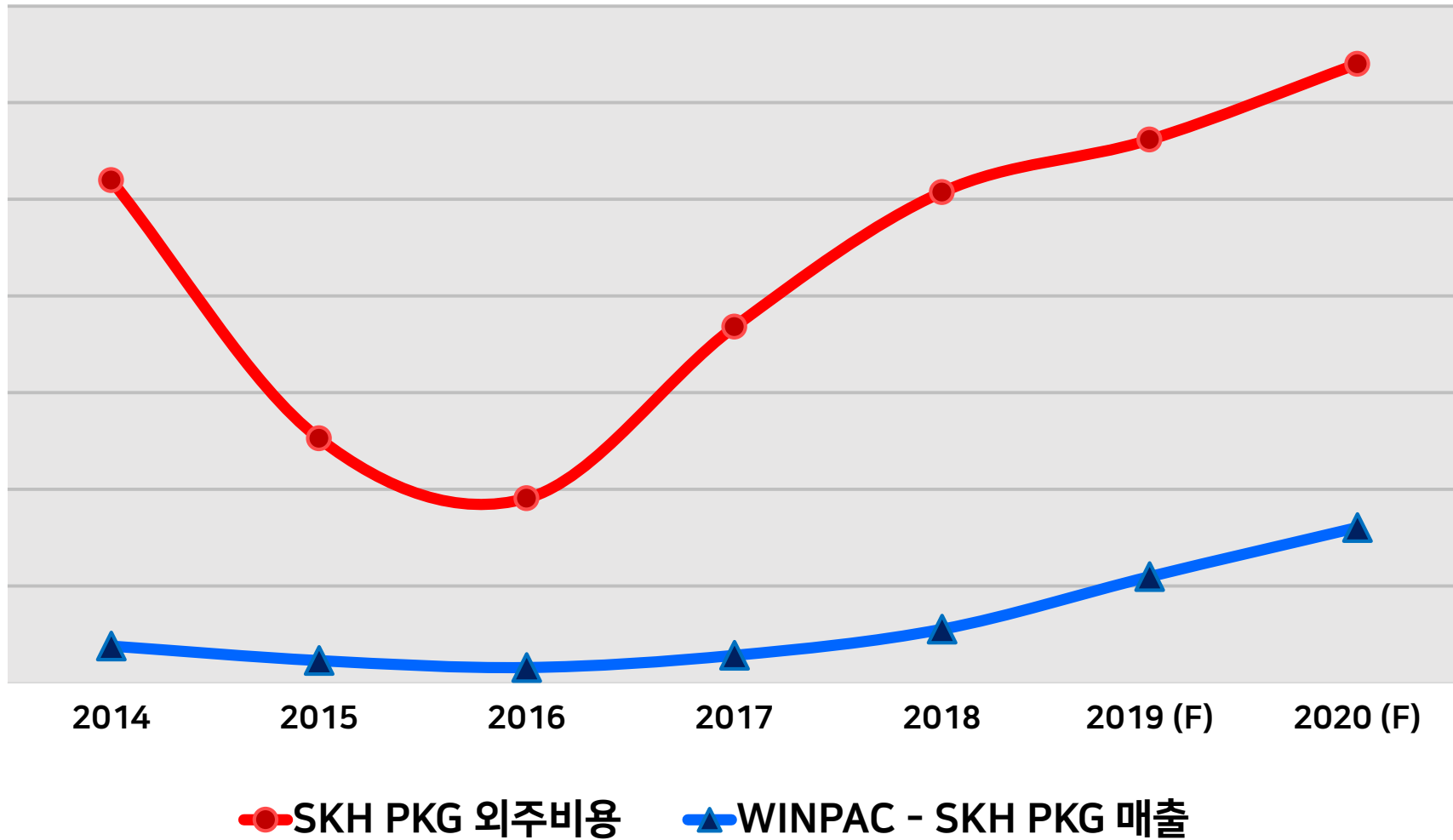
현재 주요 고객사



거래선 & 제품 다변화

- 팹리스 고객 확대
- 해외업체 거래 확대
- SKH BIZ 강화







## 2015 - 2017

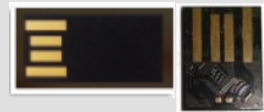
MCP(NAND/NOR)



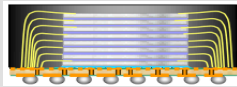
BOC (for PC)



UDP(USB Disk-P)



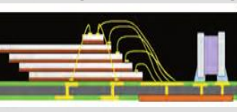
MCP (for POP)



LGA(SPI/Sensor)



SD-SiP(Flash-Mem.)



## 2018 - 2019

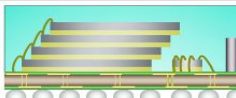
eMCP(Wearable)



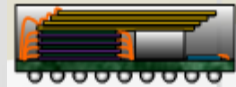
FC-BOC(MUF/C2)



eMMC5.1(Smart-P)



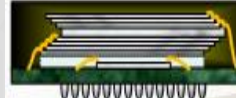
uMCP(UFS+DRAM)



Hybrid FC(MUF/C2)

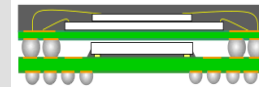


eUFS2.1/3.0(M-SSD)



## 2020 - 2023

POP(FC+MCP)



FC-CSP(eMUF/C4)



FC-FBGA(SiP)



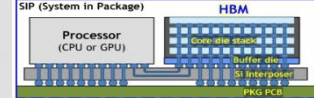
ePOP(AP+uMCP)



POP(FC+FOWLP)



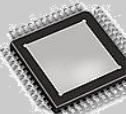
2.5D/3D(with TCB)



sTSOP/TSOP



eLQFP



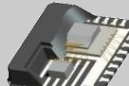
QFN (saw)



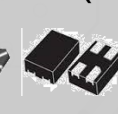
P-Wafer Recon.



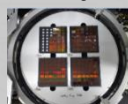
Premold QFN PKG



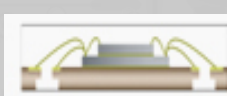
XDFN(0.5T)



W-Tray DA



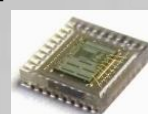
MCP-QFN(0.85T)



SiP(BGA+QFN+FC)



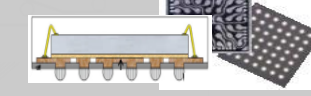
Opto-QFN(0.7T)



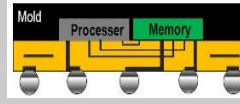
FC-QFN



BGA-QFN



FOWLP(MCP)



EMI Shielding



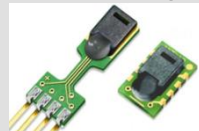
Smart Card



MCM LGA



습도 센서(HS)



근조도 센서 (ALPS)



조도 센서 (ALS)



지문인식 센서(FPS)



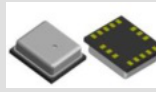
맥박 센서(PS)



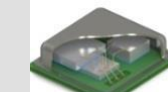
착석 센서(SS)



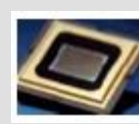
압력 센서 (PS)



기압 센서 (Barometer)

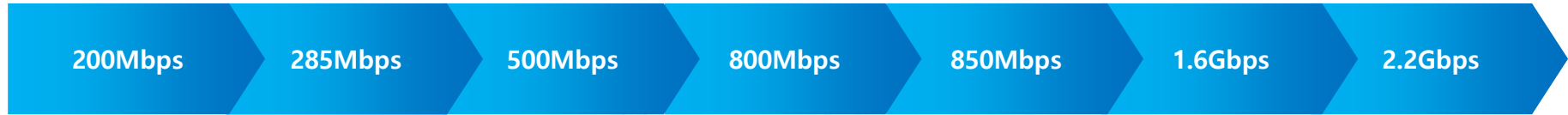


MEMS PKG (Pressure/Bio)



광암호화칩





UNI560



T5377S



T5585 / T5581H



NOS2



T5588



UNI5200



T5503

Maker	Model	Speed	Max Para	Handler
Advantest	T5503	2.2Gbps	512_1stn	TW350H, TW350HT
	T5588	850Mbps	1024_2stn	TW350H, M6243, M420
	T5588S	850Mbps	256_1stn	M430
	T5585	500Mbps	512_2stn	TW292, M6300
	T5581H	500Mbps	64_2stn	M6741
	T5377S	285Mbps	256_1stn	M6300
UNITEST	UNI5200	1.6Gbps	256_1stn	M430
	UNI560	200Mbps	128_1stn	M420, TW292
IT&T	NEOS2	800Mbps	512_1stn	M430



V93K

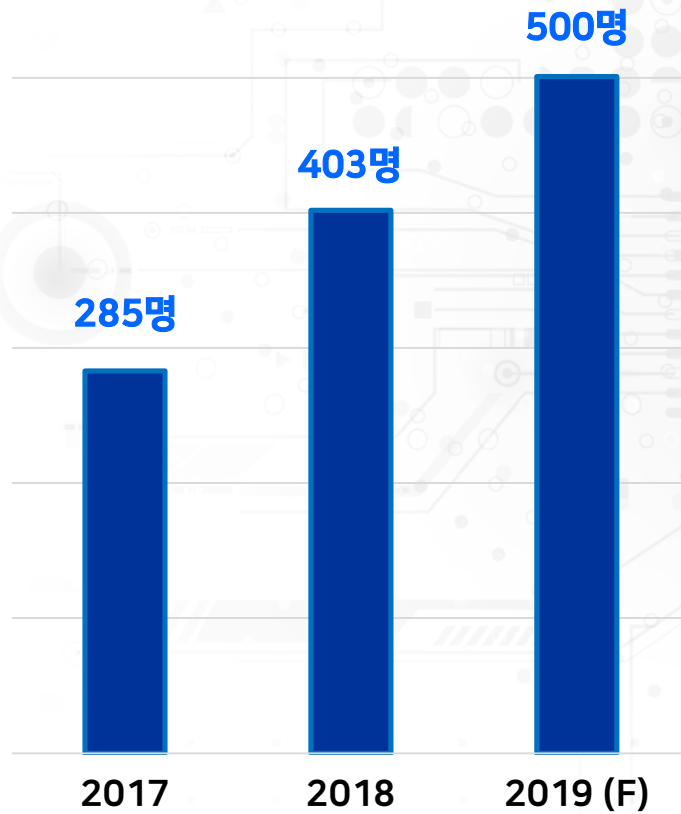


V93K

구분	FT					PT		Handler/Prober
Tester	TV01	TV02	PTV03	TV04	TV05	PTV31	PTV32	
HEAD TYPE	Small	Small	Small	Small	Compact	Small	Small	Epson NS8080 - 4대
PS1600	6장/768Ch	6장/768Ch	6장/768Ch	6장/768Ch	6장/768Ch			Synax S9 - 1대
PS9G	2장/128Ch	2장/128Ch	1장/64Ch					OPUS III - 3대
PS800						18장/576Ch	24장/768C	Turret 24 para
PS3600						4장/128Ch		
MSDPS	4장/32Ch	4장/32Ch	4장/32Ch					
DPS32			1장 32Ch	1장 32Ch	1장 32Ch	1장 32Ch	1장 32Ch	
MCB.MCE,MCA			MCA1 장		MCE 1장		MCB 1장	

## 경기도 일자리 우수기업 인증

2018. 12

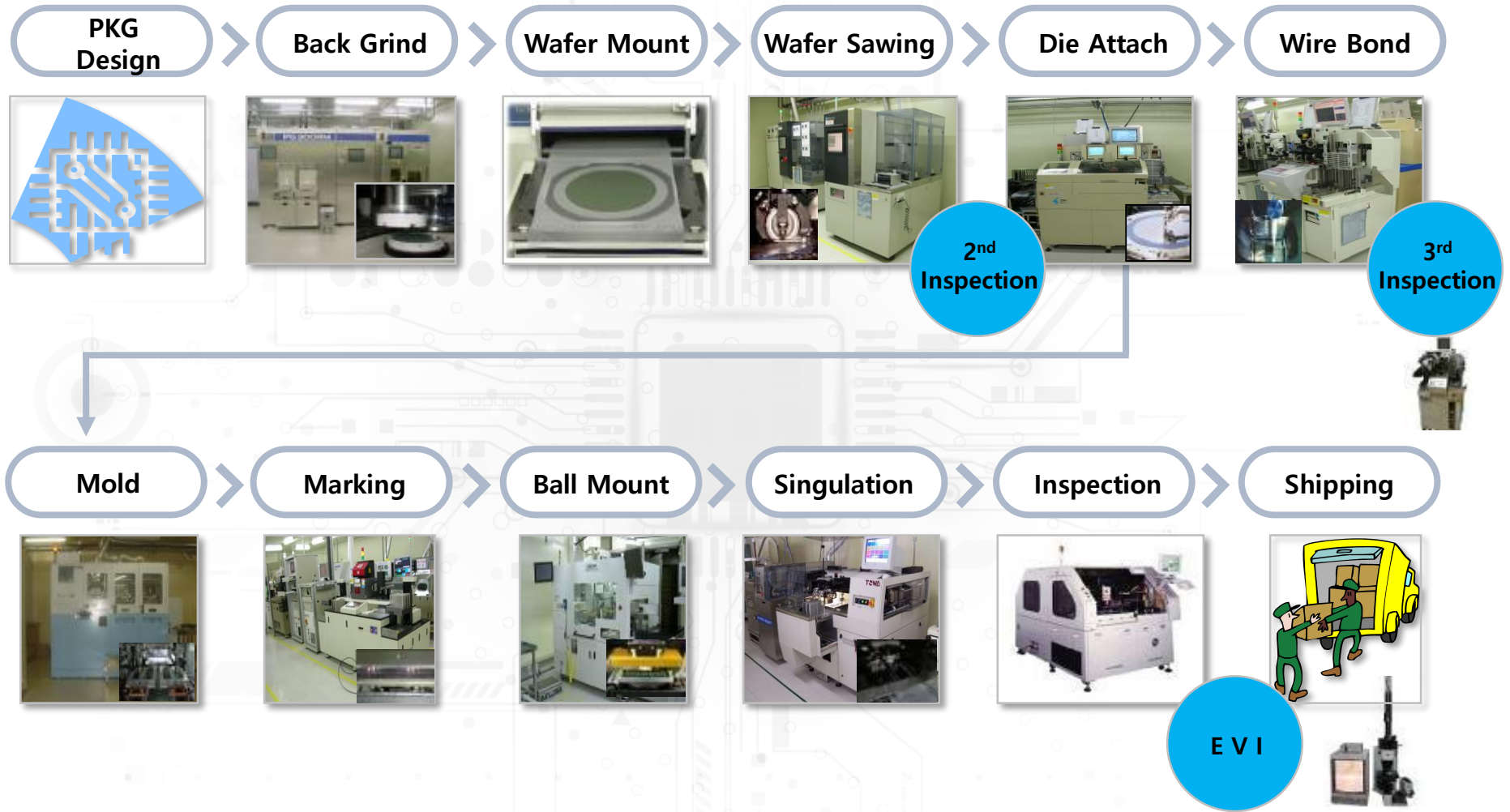


## 용인시 산업평화대상 수상

2019. 9







**WIRE BONDING  
PROCESS**

BACK-GRINDING



SAW



DIE ATTACH



WIRE BONDING

MOLD  
Normal EMC**FLIP-CHIP BONDING  
PROCESS**

BUMPED WAFER BG



BUMPED WAFER SAW



FLIP-CHIP BONDING



REFLOW

MOLD  
Molded Underfill



**감사합니다**



**WINPAC INC**

이 종목의 더 많은 IR정보 [확인하기](#)

**IR GO** 주주와 기업을 연결하고 응원합니다.